2027年3月期第2四半期
決算説明会

2026年11月12日

株式会社フジミインコーポレーテッド

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

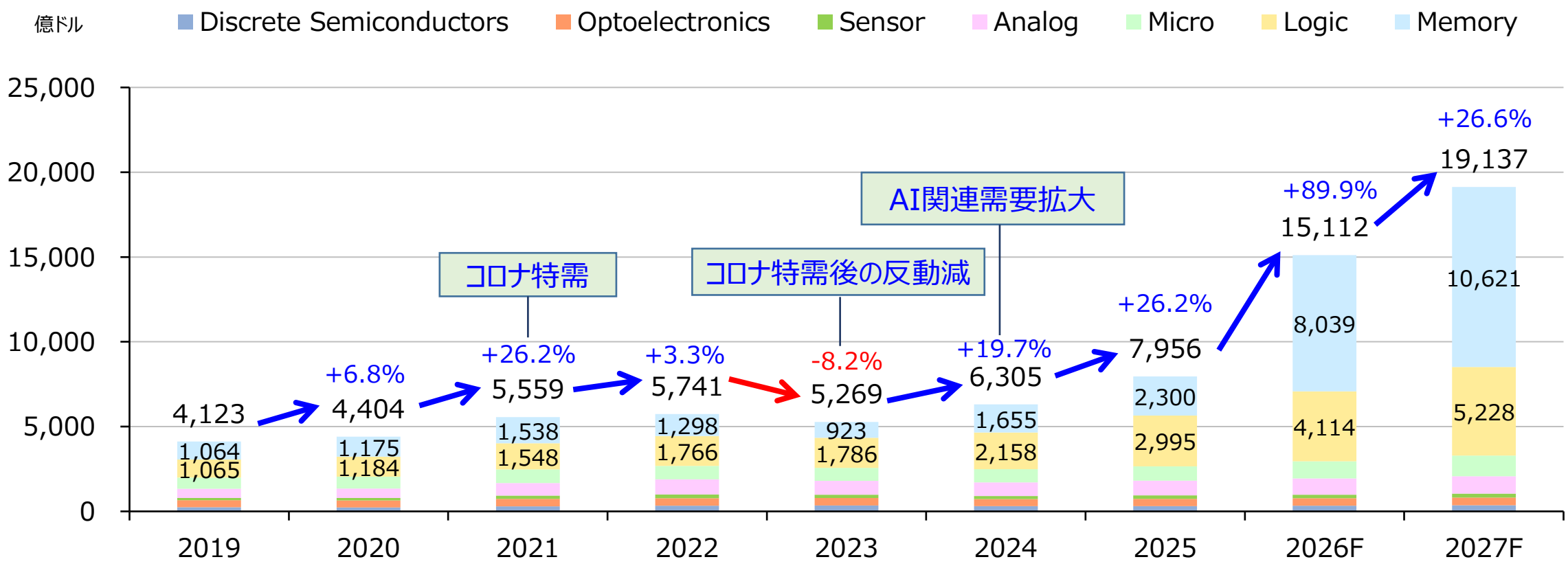
市場概況

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

世界半導体市場動向（年次実績）　用途別

出所：WSTS（2026/6）

・2025年実績　　（7,956億ドル）：データセンターインフラおよびAI関連システム向けの強い需要を背景に、ロジック・メモリが市場を牽引し、大幅成長
・2026年予想（1兆5,112億ドル）：データセンター向けの積極的な投資が継続すると見込まれ、引き続きロジック・メモリが市場を牽引し、更なる大幅成長を予想
・2027年予想（1兆9,137億ドル）：AI関連投資が継続し、自動車・産業等の用途も堅調に推移する見込み



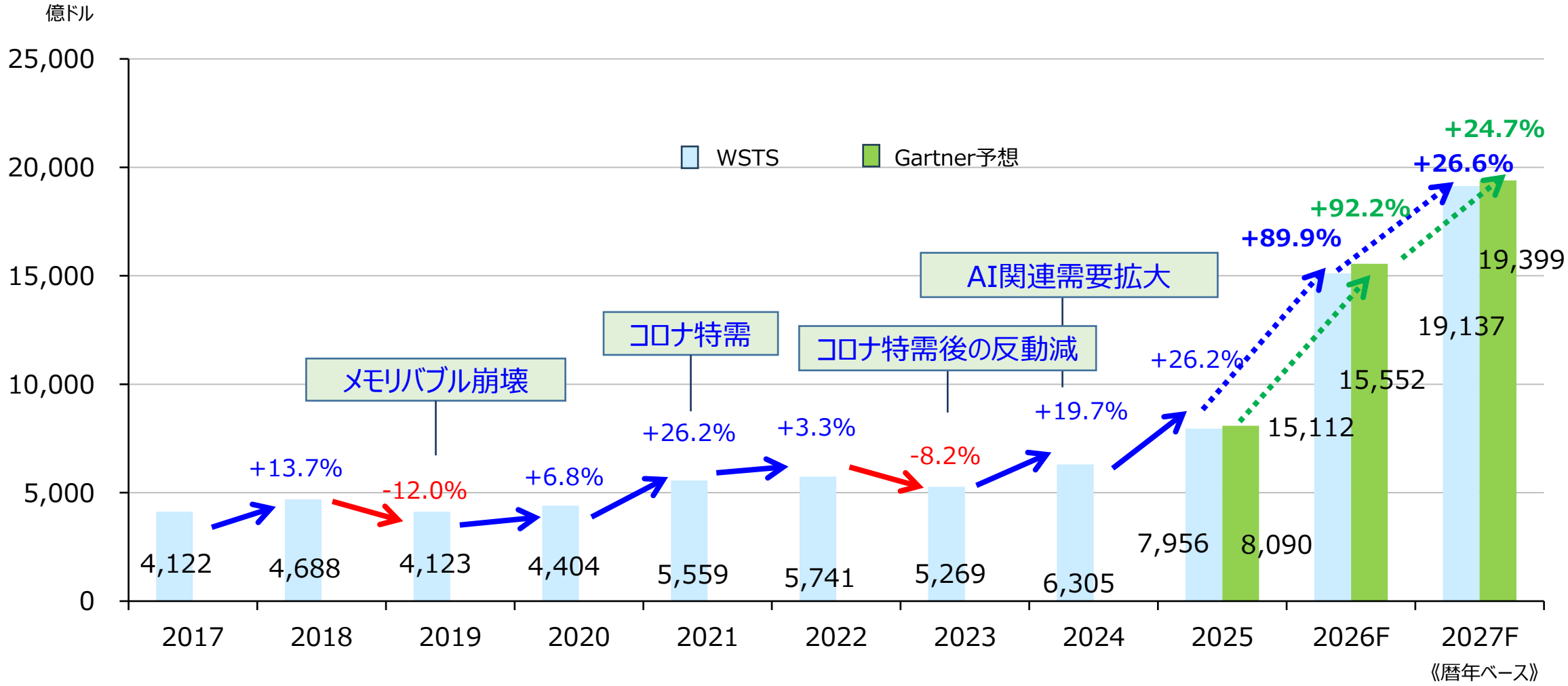
Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

世界半導体市場動向（年次　WSTS･Gartner予測）

出所：WSTS ･･･2026/6, Gartner･･･2025-2027F(2026/8)

2026年予想（WSTS　2026年6月発表）：1兆5,112億ドル
2026年予想（Gartner　2026年8月発表）：1兆5,552億ドル
2027年予想（WSTS　2026年6月発表）：1兆9,137億ドル
2027年予想（Gartner　2026年8月発表）：1兆9,399億ドル



Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

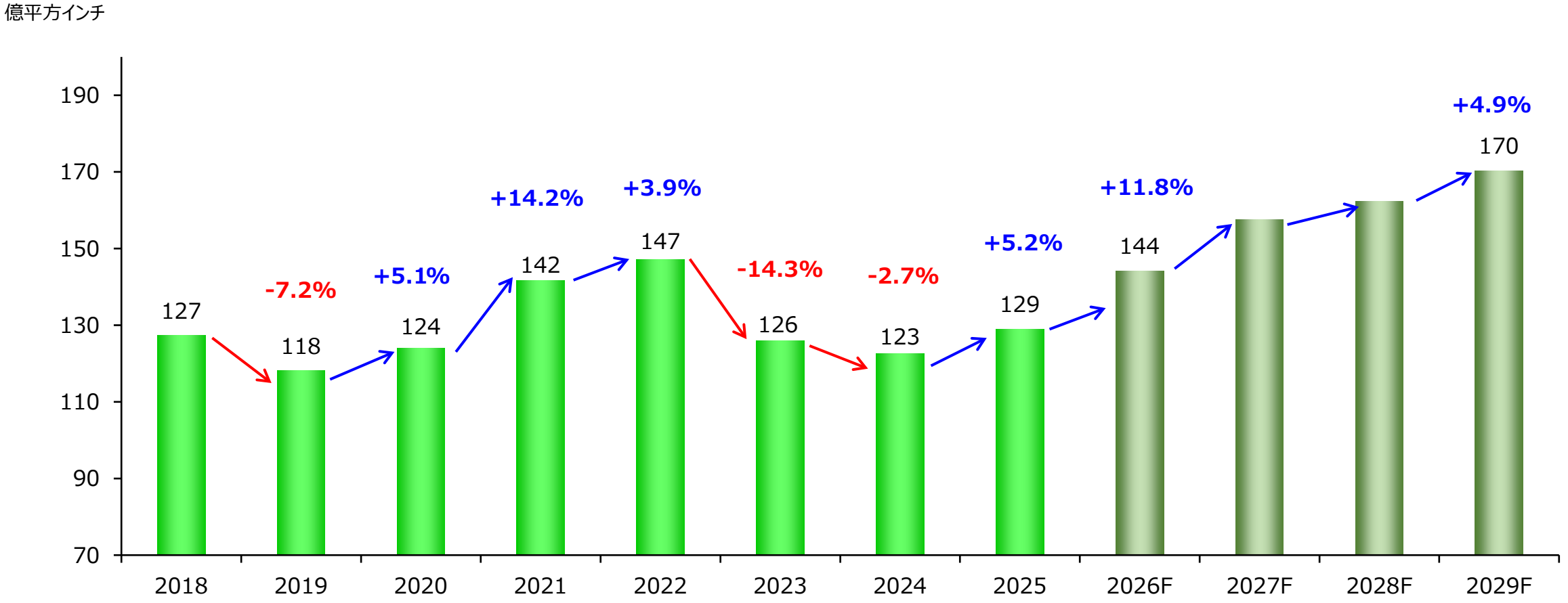
ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

シリコンウェハー需要予測（出荷面積換算　全口径）

出所：SEMI (実績 2026/2/10　予測 2026/10/21)

・2026年予想： YoY +12%・・・AI関連需要の拡大を背景に、先端ロジック・メモリ向けウェハー需要の増加、成熟ノードの稼働率回復、在庫調整の進展が成長を牽引

・2029年予想：170億3,400万平方インチ（2026年予想： 144億2,000万平方インチ）・・・AIインフラの継続拡大を見込む



Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

決算概要

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

決算概要 （上期実績）

*1 純利益：親会社株主に帰属する純利益＊2 EBITDA=営業利益+減価償却費

単位：百万円

	26年3月期		27年3月期						
	上期実績	下期実績	期初予想 ('26/5)	修正予想 ('26/10)	**上期実績**	**前年同期比**	**前年下期比**	**期初予想比**	**修正予想比**
売上高	33,496	35,908	36,200	40,500	**40,602**	**+21.2%**	**+13.1%**	**+12.2%**	**+0.3%**
営業利益	6,469	7,357	7,450	9,050	**9,416**	**+45.5%**	**+28.0%**	**+26.4%**	**+4.1%**
率	19.3%	20.5%	20.6%	22.3%	**23.2%**	-	-	-	-
経常利益	6,257	7,912	7,500	9,100	**9,459**	**+51.2%**	**+19.5%**	**+26.1%**	**+3.9%**
率	18.7%	22.0%	20.7%	22.5%	**23.3%**	-	-	-	-
純利益*1	4,671	4,387	5,500	6,750	**7,123**	**+52.5%**	**+62.4%**	**+29.5%**	**+5.5%**
率	13.9%	12.2%	15.2%	16.7%	**17.5%**	-	-	-	-
EBITDA*2	7,533	8,656	8,950	-	**10,762**	**+42.9%**	**+24.3%**	**+20.3%**	**-**
率	22.5%	24.1%	24.7%	-	**26.5%**	-	-	-	-

・半期売上高・利益は過去最高更新

- 売上高：AI半導体関連需要は堅調であり、先端半導体向けCMP製品及びシリコンウェハー向け製品を中心に増収
- 利益：収益性の高い先端半導体向けCMP製品の販売が伸び、製品構成の良化もあり増益、営業利益率上昇

・為替実績：160.0円／ドル（前年同期：146.6円／ドル）

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

業績予想 （通期予想）

*1 純利益：親会社株主に帰属する純利益＊2 EBITDA=営業利益+減価償却費

単位：百万円

	26年3月期	27年3月期					
	通期実績	期初予想	修正予想 ('26/10)	**修正予想**	**前期比**	**期初予想比**	**修正予想比**
売上高	69,404	74,800	82,500	**82,600**	**+19.0%**	**+10.4%**	**+0.1%**
営業利益	13,826	14,500	17,250	**17,600**	**+27.3%**	**+21.4%**	**+2.0%**
率	19.9%	19.4%	20.9%	**21.3%**	**-**	**-**	**-**
経常利益	14,169	14,500	17,150	**17,500**	**+23.5%**	**+20.7%**	**+2.0%**
率	20.4%	19.4%	20.8%	**21.2%**	**-**	**-**	**-**
純利益*1	9,059	10,400	12,600	**12,950**	**+42.9%**	**+24.5%**	**+2.8%**
率	13.1%	13.9%	15.3%	**15.7%**	**-**	**-**	**-**
EBITDA*2	16,190	19,200	-	**22,000**	**+35.9%**	**+14.6%**	**-**
率	23.3%	25.7%	-	**26.6%**	**-**	**-**	**-**

・売上高、利益：過去最高更新予想

- 先端半導体デバイス向けCMP製品、シリコンウェハー向け製品の販売増加を想定

・営業利益：新工場建設等の新規投資に伴う減価償却が下期に始まる一方で、売上増、製品構成の良化等により収益性は向上する想定

・当期純利益：前期に複数年度にわたる過年度法人税等を計上し、前期実績が落ち込んだこともあり、 前期比+42.9%の大幅増益

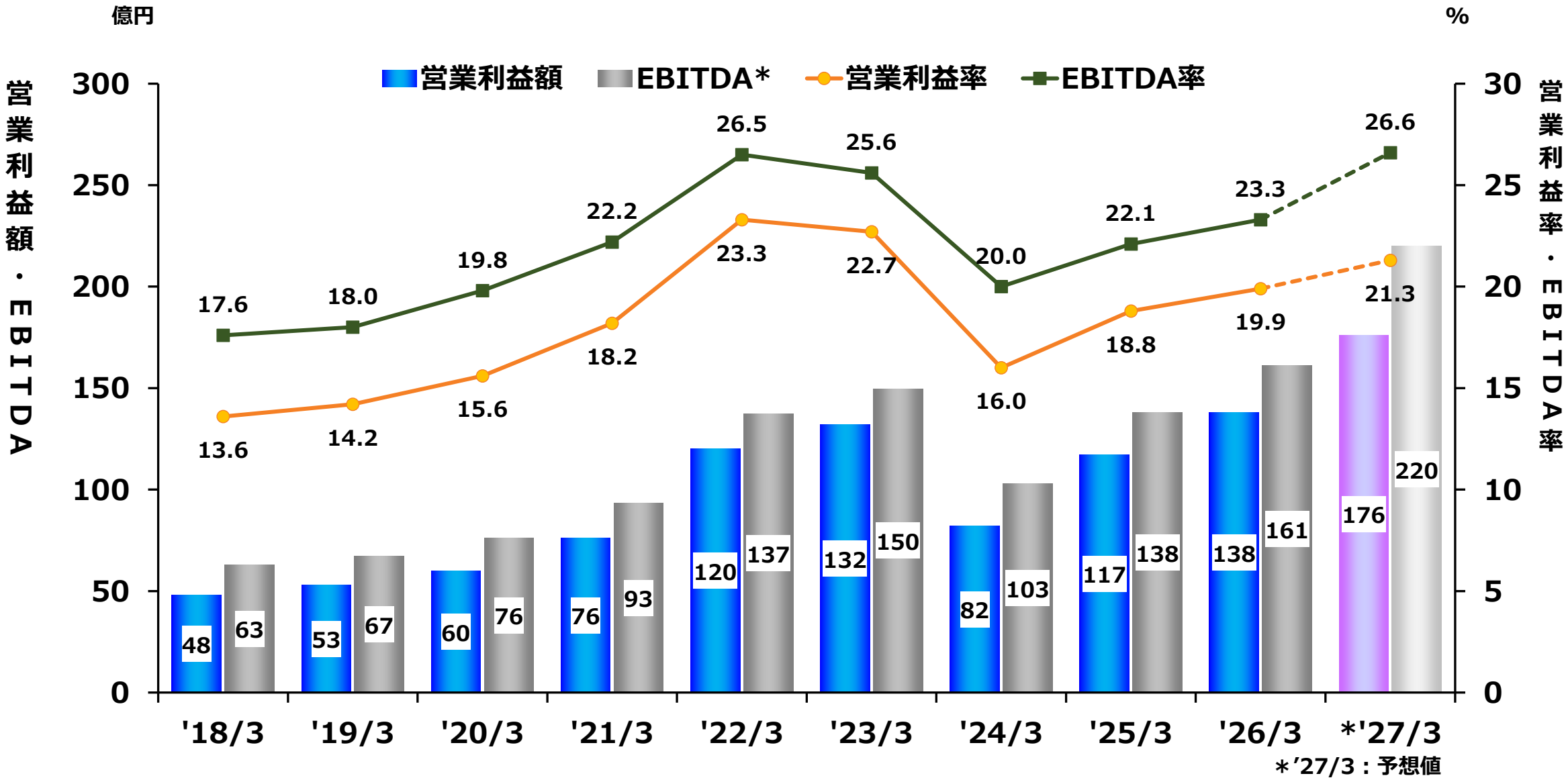
・想定為替レート：下期150.0円／ドル（前年下期実績：155.1円／ドル） 通期155.0円／ドル（前期実績：151.0円／ドル）

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

営業利益、EBITDA（今期予想含む）

＊EBITDA＝営業利益＋減価償却費



＊'27/3：予想値

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

用途別売上高

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

用途別売上高 （上期実績）

単位：百万円

		26年3月期		27年3月期				
		上期実績	下期実績	期初予想	**上期実績**	**前年同期比**	**前年下期比**	**期初予想比**
シリコン	ラッピング	3,711	3,878	3,750	**4,198**	**+13.1%**	**+8.2%**	**+12.0%**
	ポリシング	6,928	6,456	6,700	**7,140**	**+3.1%**	**+10.6%**	**+6.6%**
	切断	52	53	50	**69**	**+32.7%**	**+29.2%**	**+39.0%**
	計	10,692	10,389	10,500	**11,408**	**+6.7%**	**+9.8%**	**+8.6%**
CMP		16,732	19,403	19,600	**22,366**	**+33.7%**	**+15.3%**	**+14.1%**
ディスク		1,000	1,238	1,200	**1,389**	**+39.0%**	**+12.2%**	**+15.8%**
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	3,511	2,914	3,080	**3,603**	**+2.6%**	**+23.6%**	**+17.0%**
	一般工業用(非研磨材)	1,532	1,922	1,800	**1,789**	**+16.8%**	**△6.9%**	**△0.6%**
	計	5,044	4,836	4,880	**5,393**	**+6.9%**	**+11.5%**	**+10.5%**
製品売上高		33,468	35,868	36,180	**40,557**	**+21.2%**	**+13.1%**	**+12.1%**
商品売上高		28	40	20	**44**	**+59.4%**	**+12.1%**	**+124.9%**
売上高　合計		33,496	35,908	36,200	**40,602**	**+21.2%**	**+13.1%**	**+12.2%**

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

用途別売上高 （通期予想）

単位：百万円

		26年3月期	27年3月期			
		通期実績	期初予想	**修正予想**	**前期比**	**期初予想比**
シリコン	ラッピング	7,590	7,600	**8,600**	**+13.3%**	**+13.2%**
	ポリシング	13,384	13,500	**14,800**	**+10.6%**	**+9.6%**
	切断	106	100	**100**	**△5.8%**	**+0.0%**
	計	21,081	21,200	**23,500**	**+11.5%**	**+10.8%**
CMP		36,135	41,300	**46,200**	**+27.9%**	**+11.9%**
ディスク		2,238	2,450	**2,600**	**+16.1%**	**+6.1%**
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	6,426	6,200	**7,100**	**+10.5%**	**+14.5%**
	一般工業用(非研磨材)	3,454	3,600	**3,150**	**△8.8%**	**△12.5%**
	計	9,880	9,800	**10,250**	**+3.7%**	**+4.6%**
製品売上高		69,336	74,750	**82,550**	**+19.1%**	**+10.4%**
商品売上高		68	50	**50**	**△26.8%**	**+0.0%**
売上高　合計		69,404	74,800	**82,600**	**+19.0%**	**+10.4%**

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

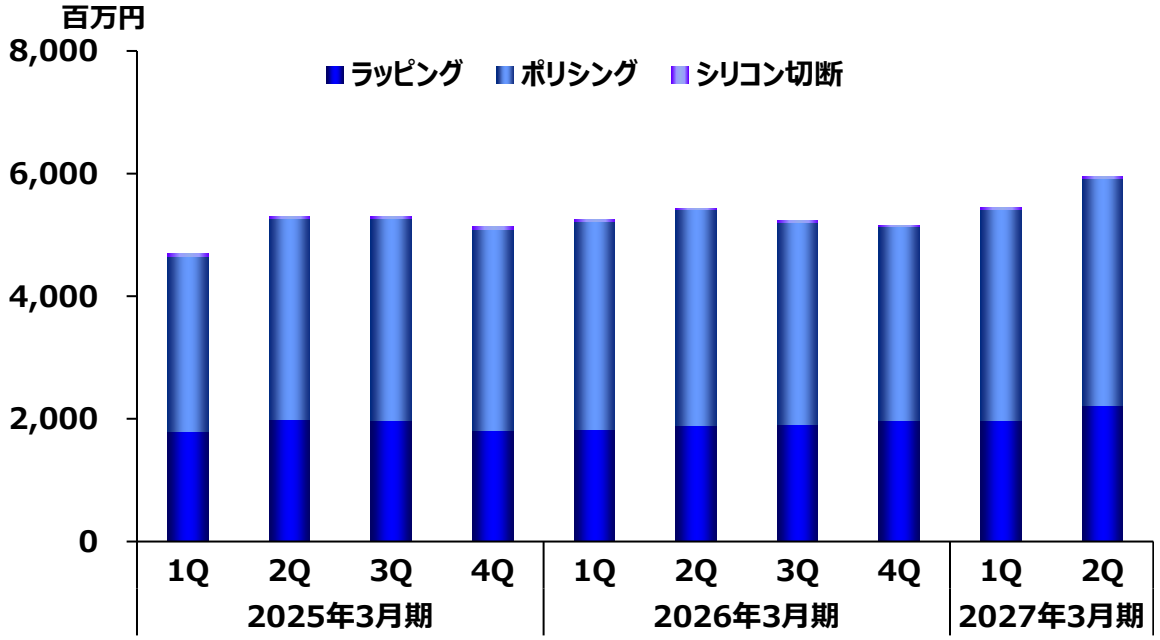
ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

シリコンウェハー売上高（上期実績）

«上期»

単位：百万円

		26年3月期		27年3月期				
		上期実績	下期実績	期初予想	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比
シリコン	ラッピング	3,711	3,878	3,750	**4,198**	**+13.1%**	**+8.2%**	**+12.0%**
	ポリシング	6,928	6,456	6,700	**7,140**	**+3.1%**	**+10.6%**	**+6.6%**
	切断	52	53	50	**69**	**+32.7%**	**+29.2%**	**+39.0%**
計		10,692	10,389	10,500	**11,408**	**+6.7%**	**+9.8%**	**+8.6%**



・事業環境
- AI･データセンター用先端ロジック、先端メモリ向けウェハーへの強い需要が継続し、300mmウェハー生産は回復基調
- 200mmウェハーの稼働も高まっている

・ラッピング、ポリシング製品の業績要因
- 上記事業環境の影響に伴い、ラッピング、ポリシング製品ともに増収

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

シリコンウェハー売上高（下期予想・通期予想）

・下期においても、300mmウェハー向けを中心に堅調維持を見込む

«下期»

単位：百万円

		26年3月期		27年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期 期初予想	**下期修正予想** ('26/11)	**前年同期比**	**同年上期比**	**期初予想比**
シリコン	ラッピング	3,711	3,878	4,198	3,850	**4,401**	**+13.5%**	**+4.8%**	**+14.3%**
	ポリシング	6,928	6,456	7,140	6,800	**7,659**	**+18.6%**	**+7.3%**	**+12.6%**
	切断	52	53	69	50	**30**	**△43.3%**	**△56.1%**	**△39.0%**
計		10,692	10,389	11,408	10,700	**12,091**	**+16.4%**	**+6.0%**	**+13.0%**

«通期»

単位：百万円

		26年3月期	27年3月期			
		通期実績	期初予想	**修正予想**	**前期比**	**期初予想比**
シリコン	ラッピング	7,590	7,600	**8,600**	**+13.3%**	**+13.2%**
	ポリシング	13,384	13,500	**14,800**	**+10.6%**	**+9.6%**
	切断	106	100	**100**	**△5.8%**	**+0.0%**
計		21,081	21,200	**23,500**	**+11.5%**	**+10.8%**

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

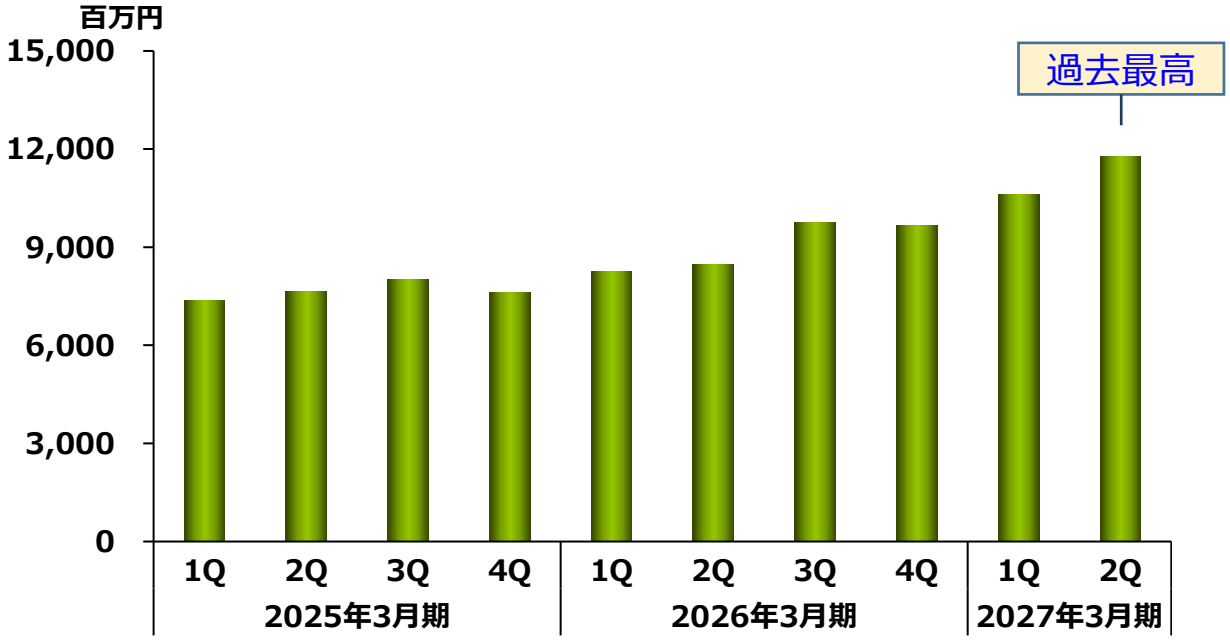
ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

CMP売上高（上期実績）

«上期»

単位：百万円

	26年3月期		27年3月期				
	上期実績	下期実績	期初予想	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比
CMP	16,732	19,403	19,600	**22,366**	**+33.7%**	**+15.3%**	**+14.1%**



- **事業環境**
  - **AI向け先端半導体デバイスは需要堅調**
- **CMP向け製品の増収要因**
  - **AI関連の先端ロジック、先端メモリ向け販売好調により四半期・半期としての売上はいずれも過去最高**
  - **後工程（先端パッケージ）向け製品が採用され、出荷開始**

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

CMP売上高（下期予想･通期予想）

・下期においても、AI向け先端半導体デバイスの需要は堅調に推移するものと想定し、通期では前期比大幅増収を見込む
・後工程（先端パッケージ）向け製品の出荷拡大を見込む

≪下期≫

単位：百万円

	26年3月期		27年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期 期初予想	**下期修正予想** ('26/11)	**前年同期比**	**同年上期比**	**期初予想比**
CMP	16,732	19,403	22,366	21,700	**23,833**	**+22.8%**	**+6.6%**	**+9.8%**

≪通期≫

単位：百万円

	26年3月期	27年3月期				
	通期実績	期初予想	**修正予想**		**前期比**	**期初予想比**
CMP	36,135	41,300	**46,200**		**+27.9%**	**+11.9%**

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

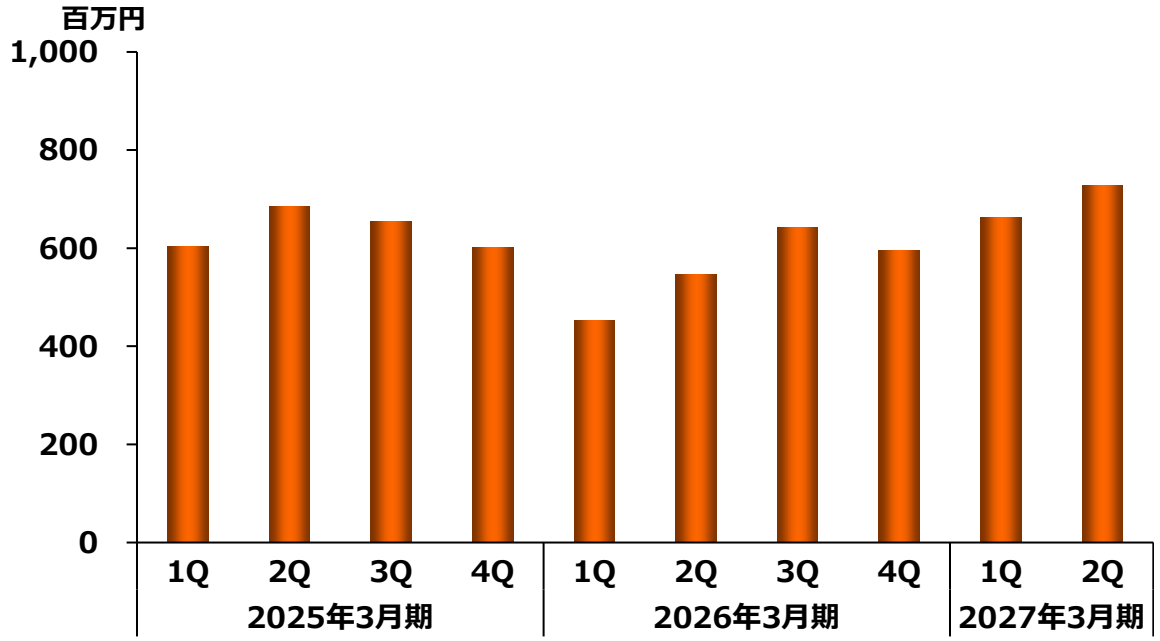
ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

ディスク売上高（上期実績）

«上期»

単位：百万円

	26年3月期		27年3月期				
	上期実績	下期実績	期初予想	**上期実績**	**前年同期比**	**前年下期比**	**期初予想比**
ディスク	1,000	1,238	1,200	**1,389**	**+39.0%**	**+12.2%**	**+15.8%**



・事業環境
- データセンター向けHDDの需要は堅調

・ディスク向け製品の増収要因
- ニアライン向けHDDの顧客稼働は好調に推移
- 在庫積増による出荷あり
- 前期1Qには、顧客の生産プロセス改善に伴う在庫調整の影響あり

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

ディスク売上高（下期予想・通期予想）

・上期に顧客による在庫積増に対応した出荷があった一方、下期は顧客の高稼働が維持される想定の下、上期比で減収
・通期では、データセンター向けＨＤＤの需要は好調に推移すると想定し、前期比増収を見込む

«下期»

単位：百万円

	26年3月期		27年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期 期初予想	**下期修正予想** ('26/11)	**前年同期比**	**同年上期比**	**期初予想比**
ディスク	1,000	1,238	1,389	1,250	**1,210**	**△2.3%**	**△12.9%**	**△3.2%**

«通期»

単位：百万円

	26年3月期	27年3月期			
	通期実績	期初予想	**修正予想**	**前期比**	**期初予想比**
ディスク	2,238	2,450	**2,600**	**+16.1%**	**+6.1%**

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

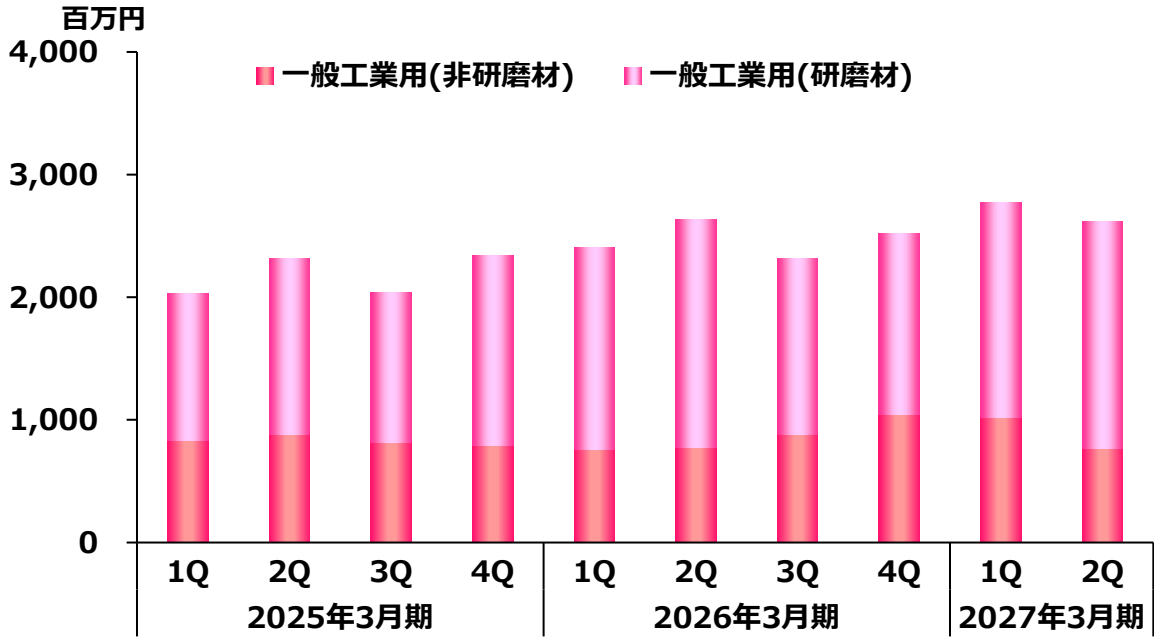
ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

機能材・溶射材売上高（上期実績）

«上期»

単位：百万円

		26年3月期		27年3月期				
		上期実績	下期実績	期初予想	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	3,511	2,914	3,080	**3,603**	**+2.6%**	**+23.6%**	**+17.0%**
	一般工業用(非研磨材)	1,532	1,922	1,800	**1,789**	**+16.8%**	**△6.9%**	**△0.6%**
	計	5,044	4,836	4,880	**5,393**	**+6.9%**	**+11.5%**	**+10.5%**



- 事業環境
  - AI向け高速データ通信インフラ需要の拡大を背景に、光通信関連材料・基板分野における設備投資が活性化
  - 半導体製造装置の設備投資は堅調
- 一般工業用（研磨材）の増収要因
  - 光電融合デバイス向け製品の需要増加
  - 研磨布紙向けにて顧客在庫積増に応じた出荷あり
- 一般工業用（非研磨材）の動向
  - 前年同期比：半導体製造装置向け製品の需要増加
  - 但し、2Q以降は原材料調達難による売上減

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

機能材・溶射材売上高（下期予想・通期予想）

- 研磨材：光電融合デバイス向けは下期も出荷拡大を見込む一方、上期における研磨布紙向けにて顧客在庫積増に応じた出荷の影響により、下期は上期比で減収
- 非研磨材：原材料調達難の影響もあり、下期は売上減となり、通期においても減収を見込む

≪下期≫

単位：百万円

		26年3月期		27年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期期初予想	下期修正予想（'26/11）	前年同期比	同年上期比	期初予想比
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	3,511	2,914	3,603	3,120	**3,496**	**+20.0%**	**△3.0%**	**+12.1%**
	一般工業用(非研磨材)	1,532	1,922	1,789	1,800	**1,360**	**△29.3%**	**△24.0%**	**△24.4%**
	計	5,044	4,836	5,393	4,920	**4,856**	**+0.4%**	**△9.9%**	**△1.3%**

≪通期≫

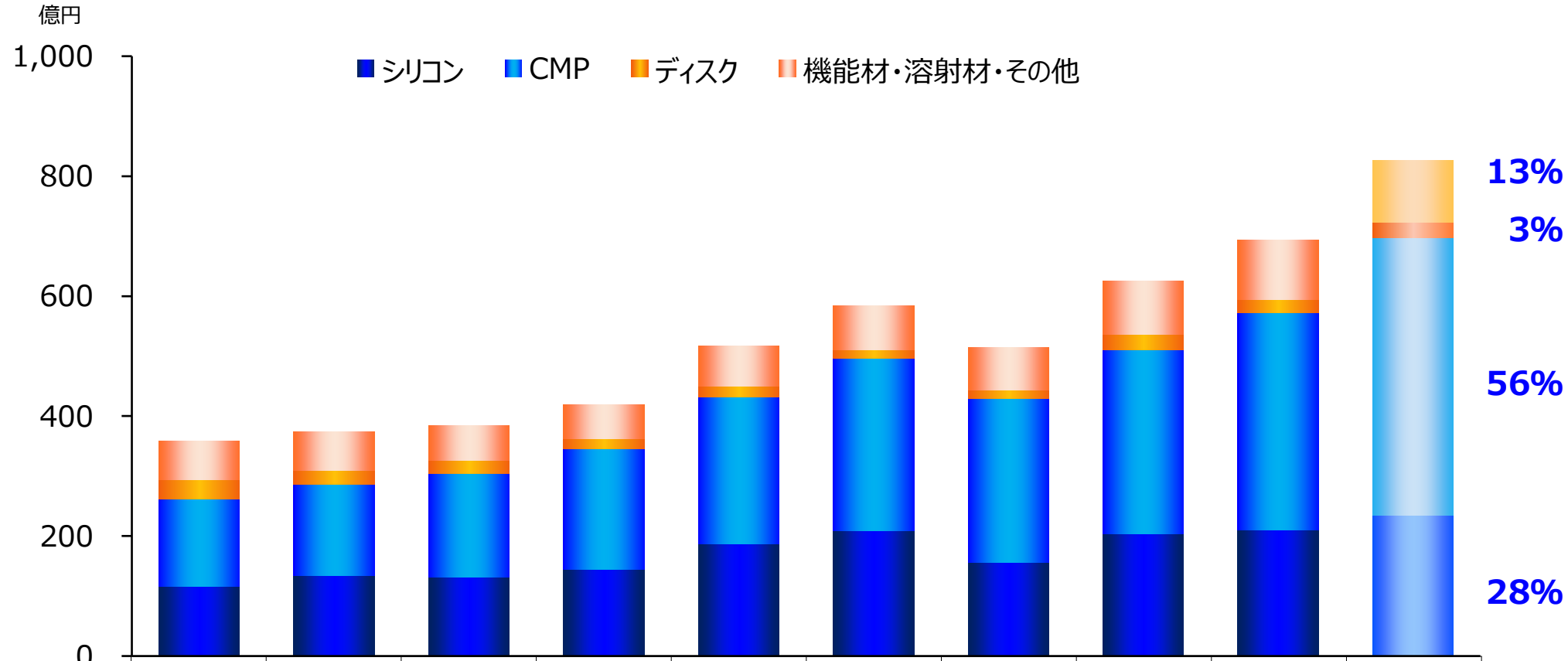
単位：百万円

		26年3月期	27年3月期			
		通期実績	期初予想	修正予想	前期比	期初予想比
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	6,426	6,200	**7,100**	**+10.5%**	**+14.5%**
	一般工業用(非研磨材)	3,454	3,600	**3,150**	**△8.8%**	**△12.5%**
	計	9,880	9,800	**10,250**	**+3.7%**	**+4.6%**

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

用途別売上高（通期）



	'18/3	'19/3	'20/3	'21/3	'22/3	'23/3	'24/3	'25/3	'26/3	*'27/3
機能材・溶射材・その他	63	64	57	57	67	73	70	88	99	103
ディスク	32	22	21	17	17	15	13	25	22	26
CMP	146	153	173	200	245	286	274	306	361	462
シリコン	115	133	131	144	186	209	155	204	210	235
計	357	373	384	419	517	583	514	625	694	826

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

＊'27/3：予想値

設備投資額

減価償却費

研究開発費

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

中期的な設備投資計画

2022年6月　2022年3月期決算説明会資料再掲

- 半導体市場の旺盛な需要に応える生産設備投資
- 先端半導体向け製品に対して高まる品質要求に応える研究開発及び品質保証関連投資

各務山新工場建設（計画）
　敷地面積：28千㎡
　‘21年12月に売買契約を締結
　・シリコン、CMP製品の生産能力増強

FUJIMI CORPORATION（米国）
　既存工場敷地内に新棟建設を計画
　・CMP生産スペース拡大

FUJIMI TAIWAN（台湾）
　・建屋増築は既に完了、順次CMP生産設備の導入を計画

- 中期視点での研究開発と新規事業の探索・育成のための投資

第２開発センター（仮称）建設（計画）
　敷地面積：16千㎡
　現研究開発センター近隣の岐阜県テクノプラザ内に用地取得済
　・非半導体関連の研究施設を設置



Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

中期的な設備投資計画（アップデート）

青色：完了

2024年11月　2025年3月期第2四半期決算説明会資料再掲

- 半導体市場の旺盛な需要に応える生産設備投資
- 先端半導体向け製品に対して高まる品質要求に応える研究開発及び品質保証関連投資

計画概要	現状（スケジュール）	将来計画
各務山新工場建設 敷地面積：28千㎡ ‘21年12月に売買契約を締結 ・シリコン、CMP製品生産能力増強	**‘24年10月　着工** ’25年末　竣工 ’26年中　試作品出荷 ’27年中　本格生産開始	【Phase2】顧客需要を見ながら、しかるべきタイミングで新工場内に生産ライン増設 【Phase3】2030年以降の需要に備え、2024年5月に新工場隣接の工場用地(34千㎡)を取得済
FUJIMI CORPORATION（米国） 既存工場敷地内に新棟建設を計画 ・CMP製品生産スペース拡大 ・SiC用製品	新棟建設計画を既存建屋内空きｽﾍﾟｰｽの生産ライン増強に切替（工期長期化懸念に備え） ‘25年末　設備設置完了	2030年以降の需要に備え、敷地内（又は新たに取得した土地）に新工場棟を建設
FUJIMI TAIWAN（台湾） ・建屋増築は既に完了、順次CMP生産設備の導入を計画	’25年末　導入完了 ’26年　生産開始	2030年以降の需要に備え、新たな工場用地の検討を当下期に開始予定

- 中期視点での研究開発と新規事業の探索・育成のための投資

第２開発センター(仮称)建設 敷地面積：16千㎡ 現研究開発センター近隣の岐阜県テクノプラザ内に用地取得済 ・非半導体関連の研究施設を設置	‘25年5月着工向けて予定通り進捗（詳細設計中）

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

中期的な設備投資計画（アップデート）

青色：完了　赤色：変更

2025年5月　2025年3月期決算説明会資料再掲

- 半導体市場の旺盛な需要に応える生産設備投資
- 先端半導体向け製品に対して高まる品質要求に応える研究開発及び品質保証関連投資

計画概要	現状（スケジュール）	将来計画
各務山新工場建設 敷地面積：28千㎡ ‘21年12月に売買契約を締結 ・シリコン、CMP製品生産能力増強	**‘24年10月　着工** ’25年末　竣工 ’26年中　試作品出荷 ’27年中　本格生産開始	【Phase2】顧客需要を見ながら、しかるべきタイミングで新工場内に生産ライン増設 【Phase3】2030年以降の需要に備え、2024年5月に新工場隣接の工場用地(34千㎡)を取得済
FUJIMI CORPORATION（米国） 既存工場敷地内に新棟建設を計画 ・CMP製品生産スペース拡大 ・SiC用製品	新棟建設計画を既存建屋内空きｽﾍﾟｰｽの生産ライン増強に切替（工期長期化懸念に備え） ‘25年末　設備設置完了	2030年以降の需要に備え、敷地内（又は新たに取得した土地）に新工場棟を建設
FUJIMI TAIWAN（台湾） ・建屋増築は既に完了、順次CMP生産設備の導入を計画	’25年末　導入完了 ’26年　生産開始	2030年以降の需要に備え、新たな工場用地の**検討を開始**

- 中期視点での研究開発と新規事業の探索・育成のための投資

第２開発センター(仮称)建設
敷地面積：16千㎡
現研究開発センター近隣の岐阜県テクノプラザ内に用地取得済
・非半導体関連の研究施設を設置

‘25年5月　着工
’26年10月　竣工

完成予想図→



Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

中期的な設備投資計画（アップデート）

青色：完了　赤色：変更

2025年11月　2026年3月期第2四半期決算説明会資料再掲

- 半導体市場の旺盛な需要に応える生産設備投資
- 先端半導体向け製品に対して高まる品質要求に応える研究開発及び品質保証関連投資

計画概要	現状（スケジュール）	将来計画
各務山新工場建設 敷地面積：28千㎡ ‘21年12月に売買契約を締結 ・シリコン、CMP製品生産能力増強	**‘24年10月　着工** ’25年末　竣工 ’26年中　試作品出荷 ’27年中　本格生産開始	【Phase2】顧客需要を見ながら、しかるべきタイミングで新工場内に生産ライン増設 【Phase3】2030年以降の需要に備え、2024年5月に新工場隣接の工場用地(34千㎡)を取得済
FUJIMI CORPORATION（米国） 既存工場敷地内に新棟建設を計画 ・CMP製品生産スペース拡大 **・SiC用製品は市場動向を鑑み見送り**	新棟建設計画を既存建屋内空きｽﾍﾟｰｽの生産ライン増強に切替（工期長期化懸念に備え） ‘25年末　設備設置完了	2030年以降の需要に備え、敷地内（又は新たに取得した土地）に新工場棟を建設
FUJIMI TAIWAN（台湾） ・建屋増築は既に完了、順次CMP生産設備の導入を計画	’25年末　導入完了 ’26年　生産開始	2030年以降の需要に備え、新たな工場用地の検討を開始

- 中期視点での研究開発と新規事業の探索・育成のための投資

第２開発センター(仮称)建設
敷地面積：16千㎡
現研究開発センター近隣の岐阜県テクノプラザ内に用地取得済
・非半導体関連の研究施設を設置

‘25年5月　着工
’26年10月　竣工

完成予想図→



Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

中期的な設備投資計画（アップデート）

青色：完了　赤色：変更

2026年5月　2026年3月期決算説明会資料再掲

- 半導体市場の旺盛な需要に応える生産設備投資
- 先端半導体向け製品に対して高まる品質要求に応える研究開発及び品質保証関連投資

計画概要	現状（スケジュール）	将来計画
各務山新工場建設 敷地面積：28千㎡ ‘21年12月に売買契約を締結 ・シリコン、CMP製品生産能力増強	**‘24年10月　着工** **’26年2月　竣工** ’26年中　試作品出荷 ’27年中　本格生産開始	【Phase2】顧客需要を見ながら、しかるべきタイミングで新工場内に生産ライン増設 【Phase3】2030年以降の需要に備え、2024年5月に新工場隣接の工場用地(34千㎡)を取得済
FUJIMI CORPORATION（米国） 既存工場敷地内に新棟建設を計画 ・CMP製品生産スペース拡大 ・SiC用製品は市場動向を鑑み見送り	新棟建設計画を既存建屋内空きｽﾍﾟｰｽの生産ライン増強に切替（工期長期化懸念に備え） **’27年4月　増産開始**	2030年以降の需要に備え、敷地内（又は新たに取得した土地）に新工場棟を建設
FUJIMI TAIWAN（台湾） ・建屋増築は既に完了、順次CMP生産設備の導入を計画	**’25年末　導入完了** **’26年6月　増産開始**	2030年以降の需要に備え、新たな工場用地を選定中

- 中期視点での研究開発と新規事業の探索・育成のための投資

第２開発センター(仮称)建設 敷地面積：16千㎡ 現研究開発センター近隣の岐阜県テクノプラザ内に用地取得済 ・非半導体関連の研究施設を設置	**‘25年5月　着工** ’26年10月　竣工 完成予想図→



Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

中期的な設備投資計画（各務山新工場アップデート）

2026年2月撮影

2026年5月　2026年3月期決算説明会資料再掲

各務山新工場　2026年2月竣工







青枠：各務山新工場
赤枠：将来の拡張に向けた取得済み工場用地

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

中期的な設備投資計画（アップデート）

- 半導体市場の旺盛な需要に応える生産設備投資
- 先端半導体向け製品に対して高まる品質要求に応える研究開発及び品質保証関連投資

青色：完了　赤色：変更

計画概要	現状（スケジュール）	将来計画
各務山新工場建設 敷地面積：28千㎡ ‘21年12月に売買契約を締結 ・シリコン、CMP製品生産能力増強	**‘24年10月　着工** **‘26年2月　竣工** ’26年中　試作品出荷 ’27年中　本格生産開始	【Phase2】顧客需要を見ながら、しかるべきタイミングで新工場内に生産ライン増設 【Phase3】2030年以降の需要に備え、2024年5月に新工場隣接の工場用地(34千㎡)を取得済
FUJIMI CORPORATION（米国） 既存工場敷地内に新棟建設を計画 ・CMP製品生産スペース拡大 ・SiC用製品は市場動向を鑑み見送り	新棟建設計画を既存建屋内空きｽﾍﾟｰｽの生産ライン増強に切替（工期長期化懸念に備え） ’27年4月　増産開始	2030年以降の需要に備え、敷地内（又は新たに取得した土地）に新工場棟を建設
FUJIMI TAIWAN（台湾） ・建屋増築は既に完了、順次CMP生産設備の導入を計画	**’25年末　導入完了** **’26年6月　増産開始**	2030年以降の需要に備え、新たな工場用地を選定中

- 中期視点での研究開発と新規事業の探索・育成のための投資

イノベーションセンター(第２開発センター)建設
敷地面積：16千㎡
現研究開発センター近隣の岐阜県テクノプラザ内に用地取得済
・非半導体関連の研究施設を設置

‘25年5月　着工
’26年12月　竣工

2026年10月撮影→



Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

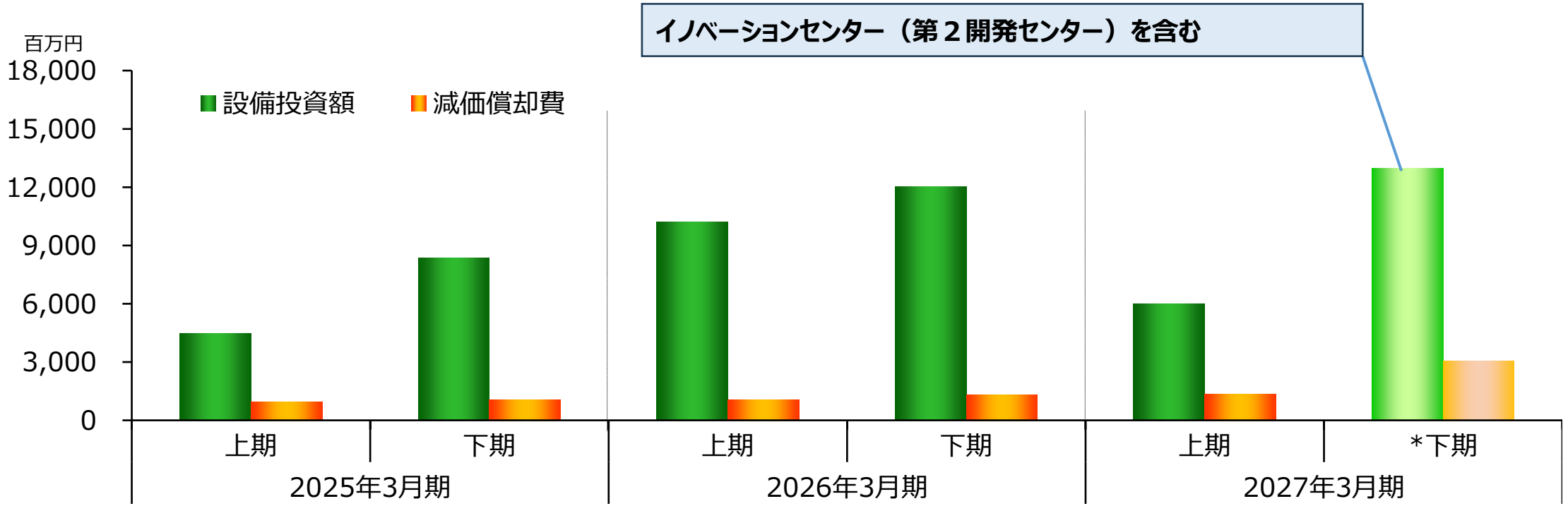
ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

設備投資額･減価償却費（上期実績･下期計画）

単位：百万円

	26年3月期		27年3月期									
	上期実績	下期実績	上期 期初計画	**上期実績**	前年同期比	前年下期比	期初計画比	下期 期初計画	**下期 見直し計画**	**前年同期比**	**同年上期比**	**期初計画比**
設備投資額	10,201	12,034	7,000	**6,015**	△41.0%	△50.0%	△14.1%	11,400	**12,985**	**+7.9%**	**+115.9%**	**+13.9%**
減価償却費	1,064	1,299	1,500	**1,346**	+26.5%	+3.6%	△10.3%	3,200	**3,054**	**+135.1%**	**+126.9%**	**△4.6%**

＊設備投資額：支払基準



＊'27/3下期：計画

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

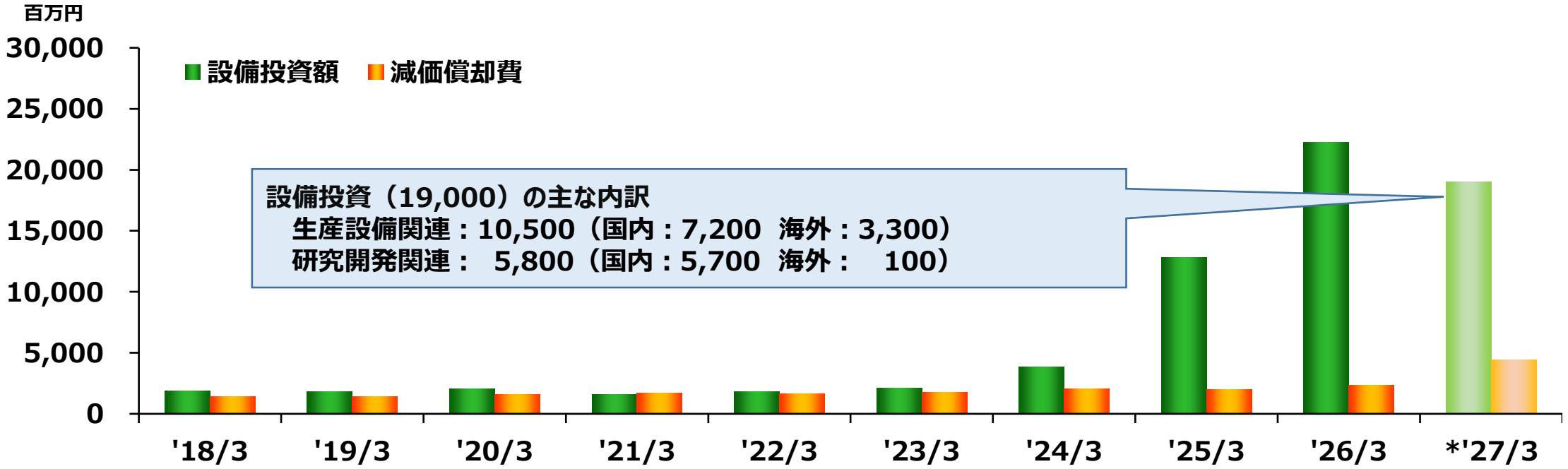
ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

設備投資額･減価償却費（通期実績･通期計画）

単位：百万円

	26年3月期	27年3月期			
	通期実績	期初計画	**修正計画**	**前期比**	**期初計画比**
設備投資額	22,235	18,400	**19,000**	**△14.5%**	**+3.3%**
減価償却費	2,363	4,700	**4,400**	**+86.2%**	**△6.4%**

＊設備投資額：支払基準



＊'27/3：計画

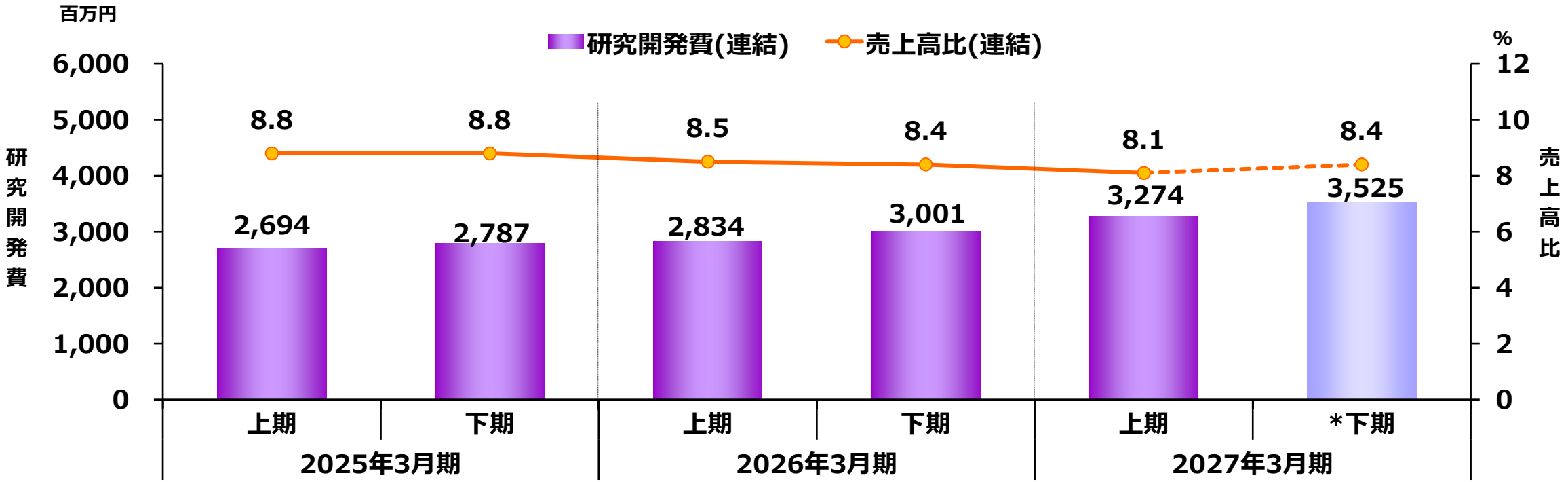
Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

研究開発費／売上高比（上期実績･下期計画）

単位：百万円

	26年3月期		27年3月期									
	上期実績	下期実績	上期期初計画	**上期実績**	前年同期比	前年下期比	期初計画比	下期期初計画	**下期見直し計画**	**前年同期比**	**同年上期比**	**期初計画比**
研究開発費	2,834	3,001	3,300	**3,274**	+15.5%	+9.1%	△0.8%	3,500	**3,525**	**+17.5%**	**+7.7%**	**+0.7%**



Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

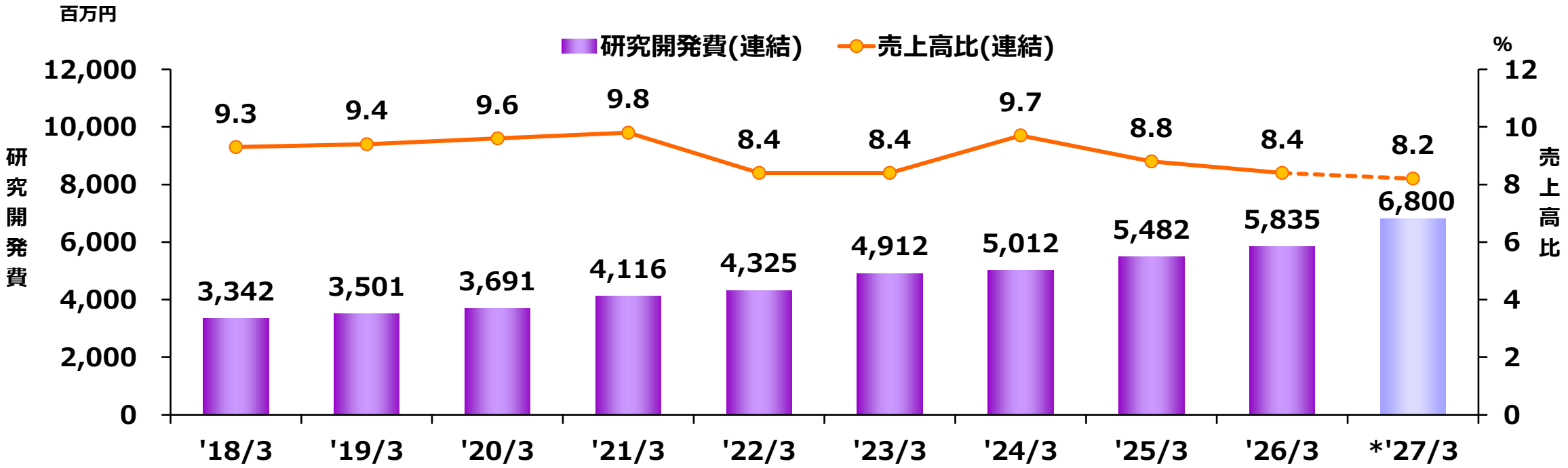
ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

＊'27/3下期：計画

研究開発費／売上高比（通期実績･通期計画）

単位：百万円

	26年3月期	27年3月期			
	通期実績	期初計画	修正計画	前期比	期初計画比
研究開発費	5,835	6,800	**6,800**	**+16.5%**	**+0.0%**



Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

＊'27/3：計画

損益分析

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

営業利益増減要因（26/3期上期実績→27/3期上期実績）

売上高　335億円

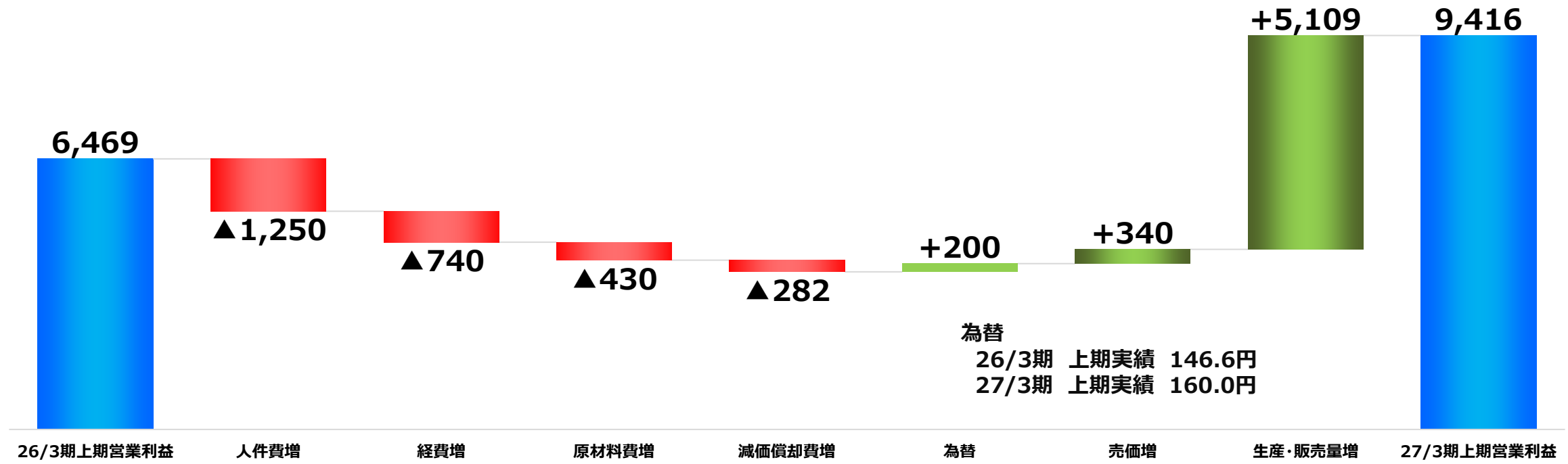
26/3期
上期実績

（売上増）+7,106百万円
（利益増）+2,947百万円

406億円

27/3期
上期実績

百万円



Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

営業利益増減要因（26/3期通期実績→27/3期通期予想）

売上高　694億円

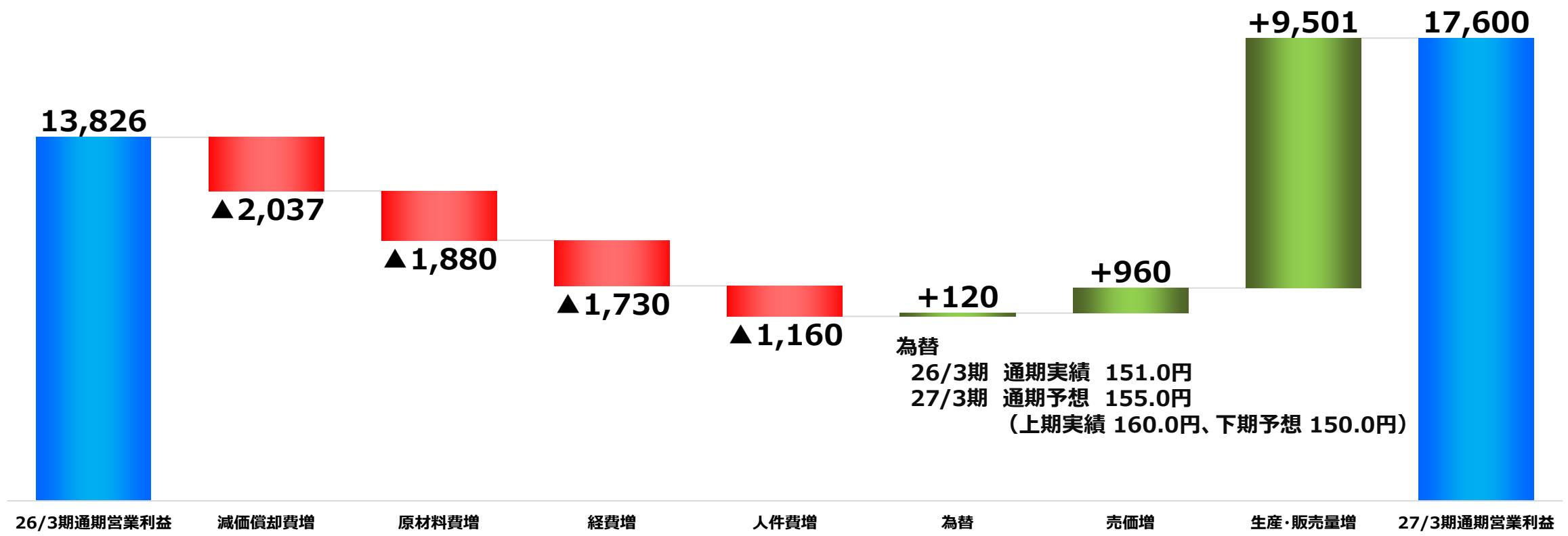
（売上増）+13,196百万円
（利益増）　+3,774百万円

826億円

26/3期
通期実績

27/3期
通期予想

百万円



Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

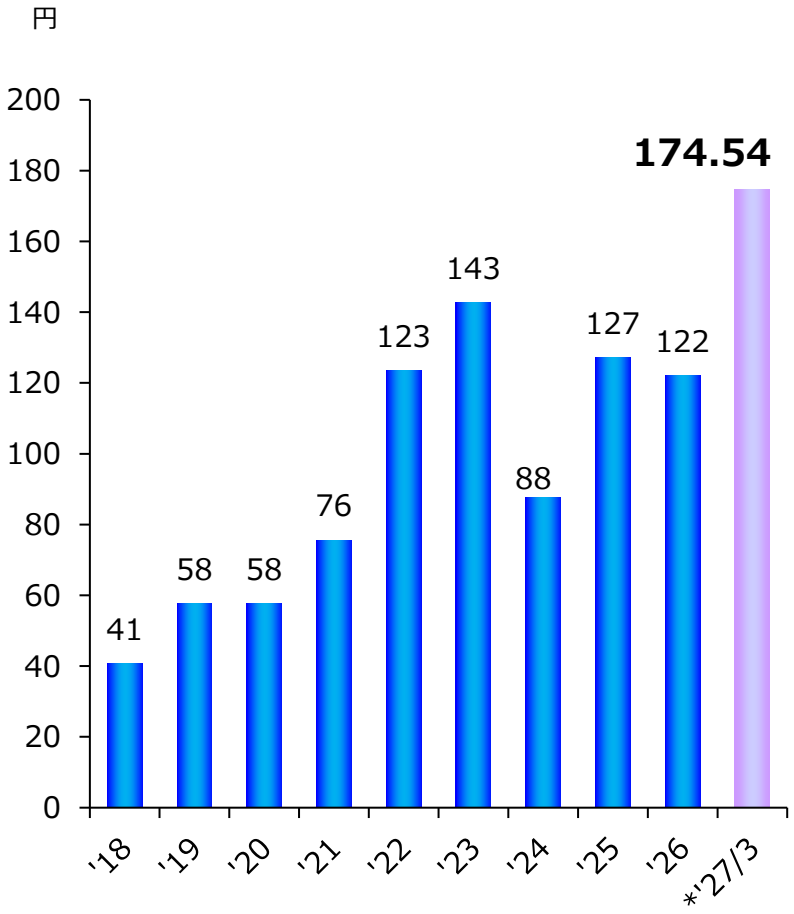
ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

株主還元

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

積極的な株主還元と安定配当の継続

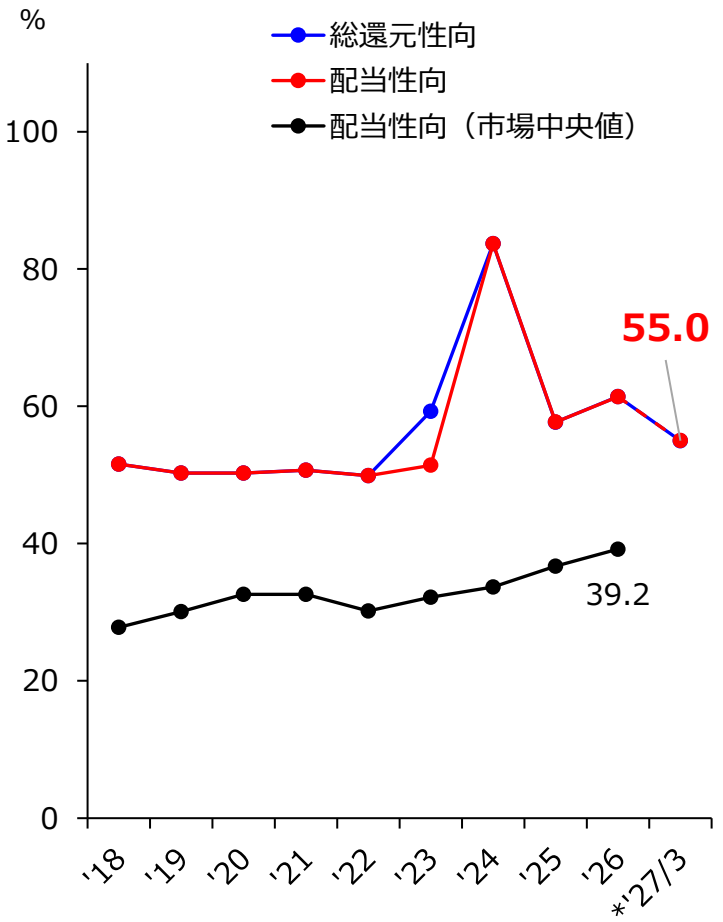
1株当たり当期純利益



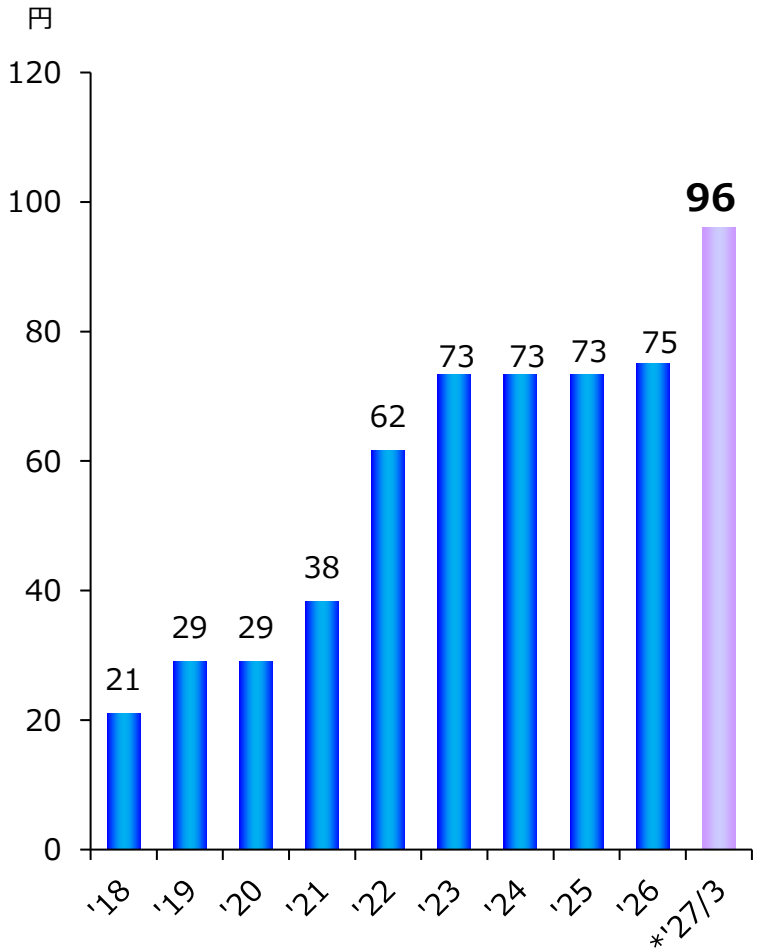
＊'27/3：予想値

総還元性向・配当性向

配当性向（市場中央値）は、'22/3期よりプライム市場のみ



1株当たり配当金**



** 1株当たり配当金：当社は、2023年７月１日付で普通株式１株につき３株の割合をもって株式分割を行っており、2023年3月期以前の1株当たり配当金においても当該株式分割が行われたと仮定して記載しております。

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp

2027年3月期　上期業績サマリー／通期業績予想

*1 純利益：親会社株主に帰属する純利益＊2 EBITDA=営業利益+減価償却費

【2027年3月期　上期業績】　*前年同期比

✓	売上高	*+21.2%	：売上高、利益、EBITDAにおいて半期過去最高を更新
✓	営業利益	+45.5%	：収益性の高い先端半導体向けCMP製品の販売増加に伴う製品構成の良化もあり、大幅増益
✓	経常利益	+51.2%	：
✓	純利益*1	+52.5%	：
✓	EBITDA*2	+42.9%	：
✓	シリコンウェハー向け	+6.7%	：先端向けの販売好調による増収
✓	CMP向け	+33.7%	：AI関連の先端ロジックや先端メモリ向けの販売好調による増収
✓	ハードディスク向け	+39.0%	：高稼働が続くニアラインHDD向けの販売好調による増収
✓	一般工業用向け	+6.9%	：高速データ通信向け研磨材や半導体製造装置向け溶射材等の販売好調による増収
✓	株主還元		：１株当たり配当額は前期上期36.67円から13.33円増配の50円

【2027年3月期　通期業績予想】　**前年比

✓	売上高	**+19.0%	：先端半導体デバイス向けCMP製品及びシリコンウェハー向け製品の販売増加を想定し、増収・増益を見込む
✓	営業利益	+27.3%	：
✓	経常利益	+23.5%	：
✓	純利益*1	+42.9%	：前期に複数年度にわたる過年度法人税等を計上したこともあり、営業・経常利益に比べ大幅増益
✓	EBITDA*2	+26.6%	：

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.

ご質問受付メールアドレス：ml_webinquiry_ir@fujimiinc.co.jp



FUJIMI INCORPORATED

Copyright(c) 2026 Fujimi Incorporated. All rights reserved.